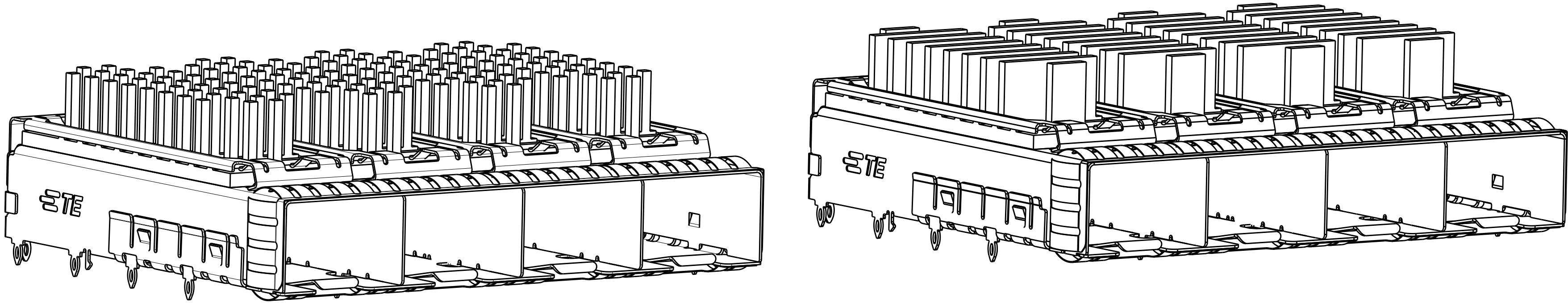


LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
GP	00		A	RELEASED PER ECO-12-013192	06NOV2012	BMM	MRS	
			A1	RELEASED PER ECO-13-014600	11SEP2013	PP	SH	
			A3	RELEASED PER ECO-15-006578	20APR2015	PP	SH	

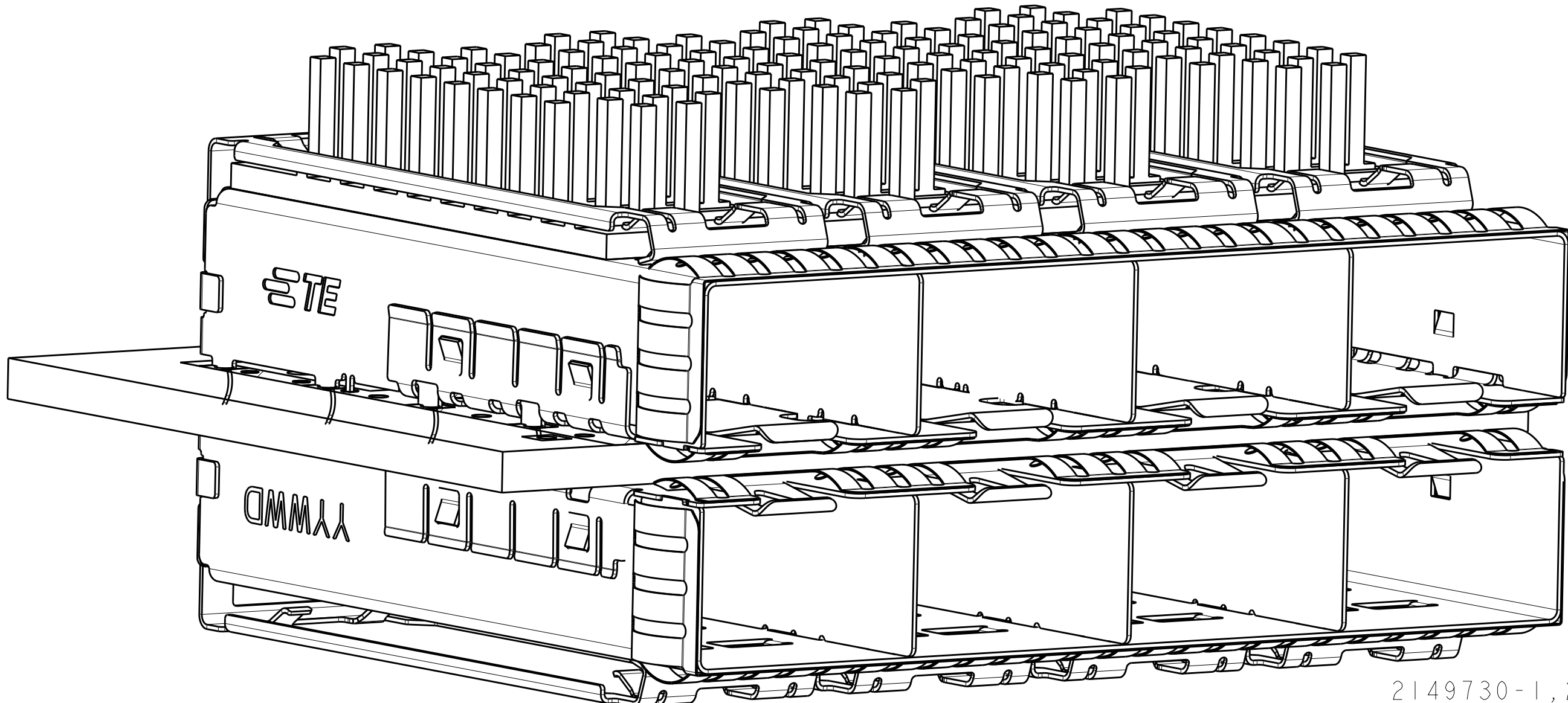
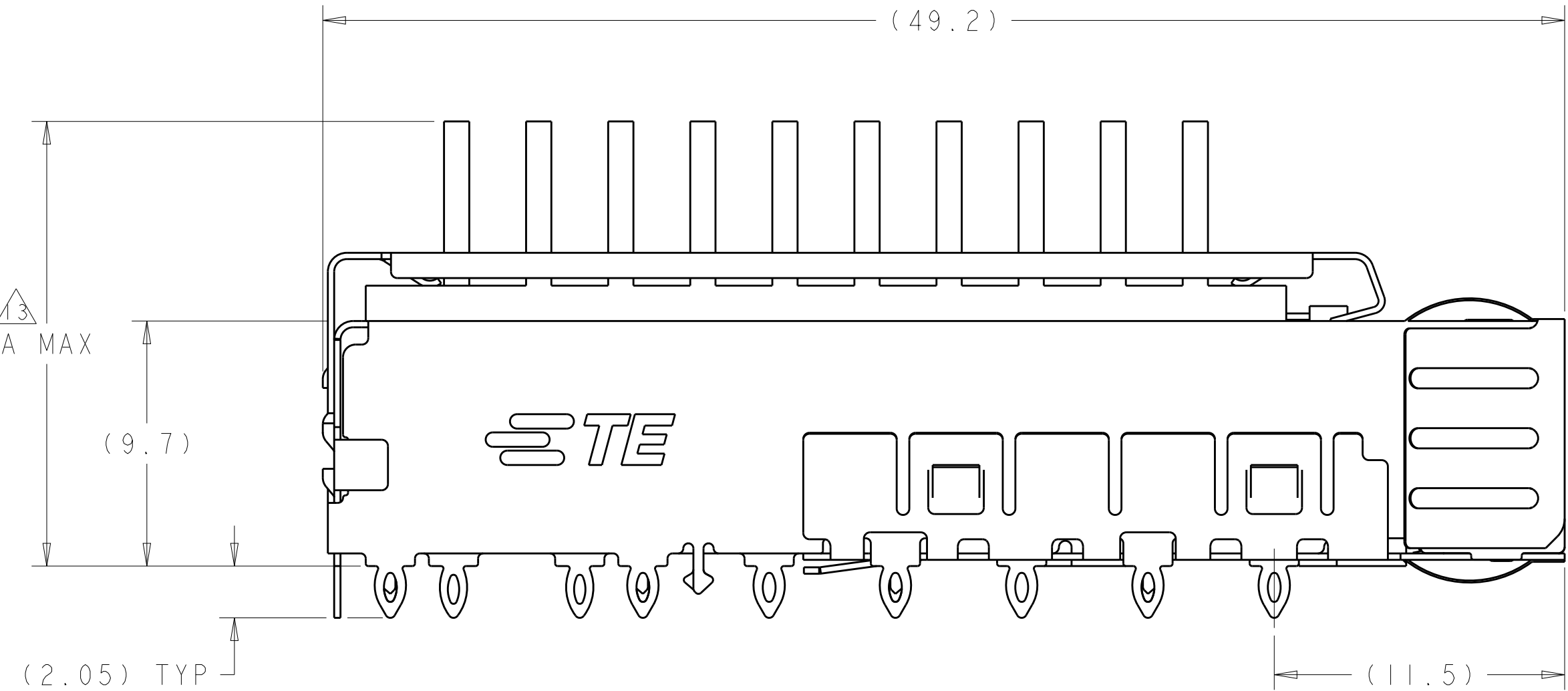
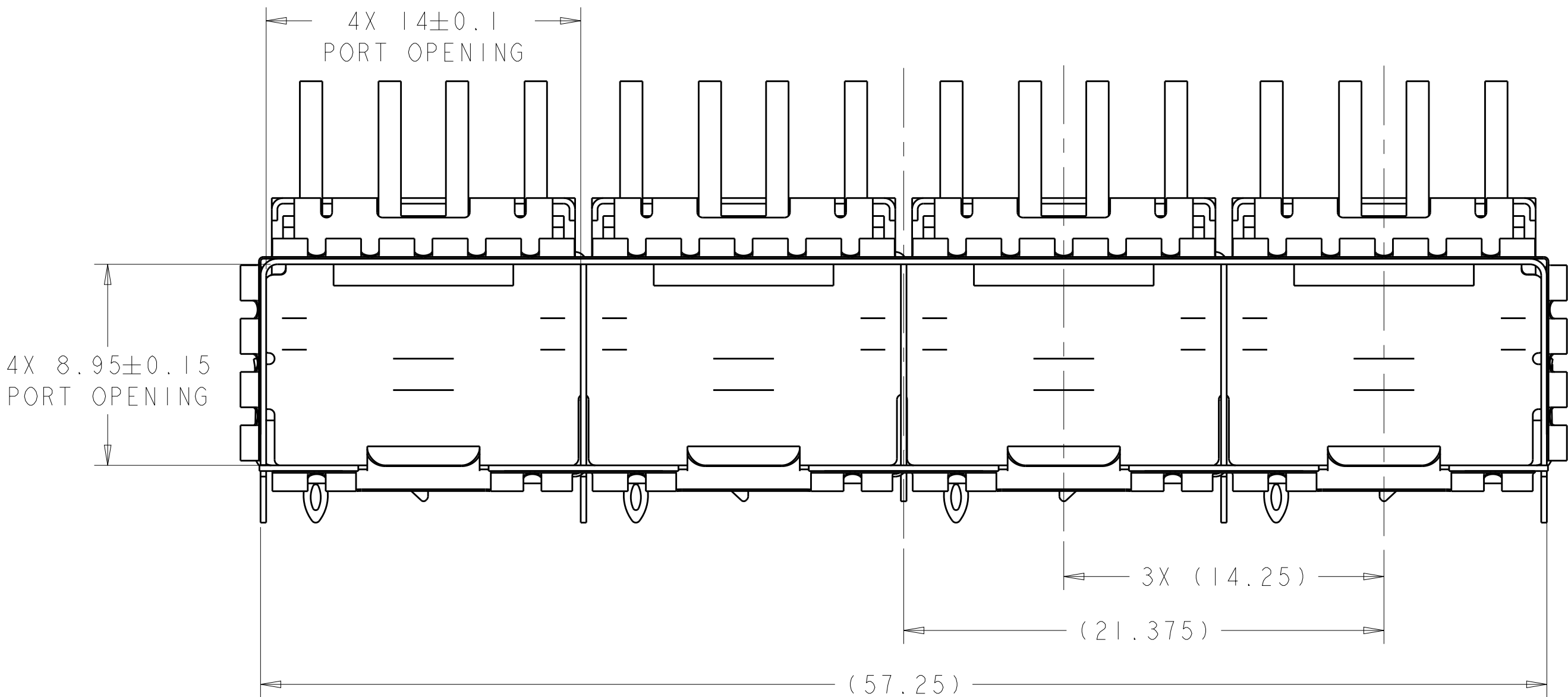


2149730-1,2,3,4,5
FINISHED ASSEMBLY WITH
PIN TYPE HEAT SINK

2149730-6,7,8,9,10
FINISHED ASSEMBLY WITH
FIN TYPE HEAT SINK

- 1 MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
HEATSINK CLIP: STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINUM
- 2 FINISH:
EMI SPRINGS: MINIMUM OF 0.8um TIN PLATE OVER A MINIMUM OF 0.8um NICKEL UNDERPLATE.
NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
HEATSINK: ELECTROLESS NICKEL
HEATSINK CLIP: PASSIVATE
- 3 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 4 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
6. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OF ASME Y14.5M-1994.
- 7 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 9 HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT. SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.
- 10 MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED = 1.50mm
DOUBLE SIDED = 2.25mm
11. CERTAIN MATING TRANSCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FROM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.

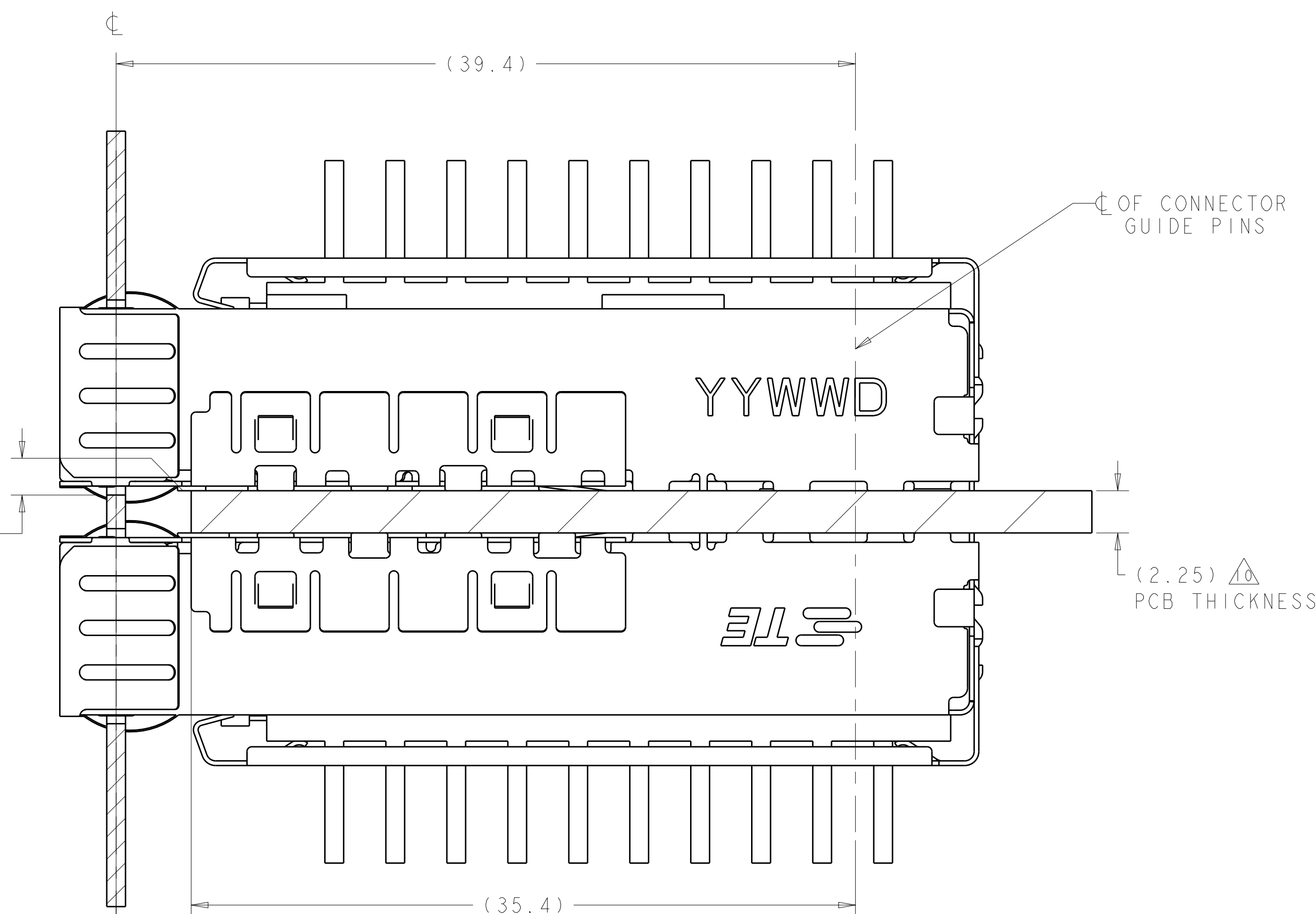
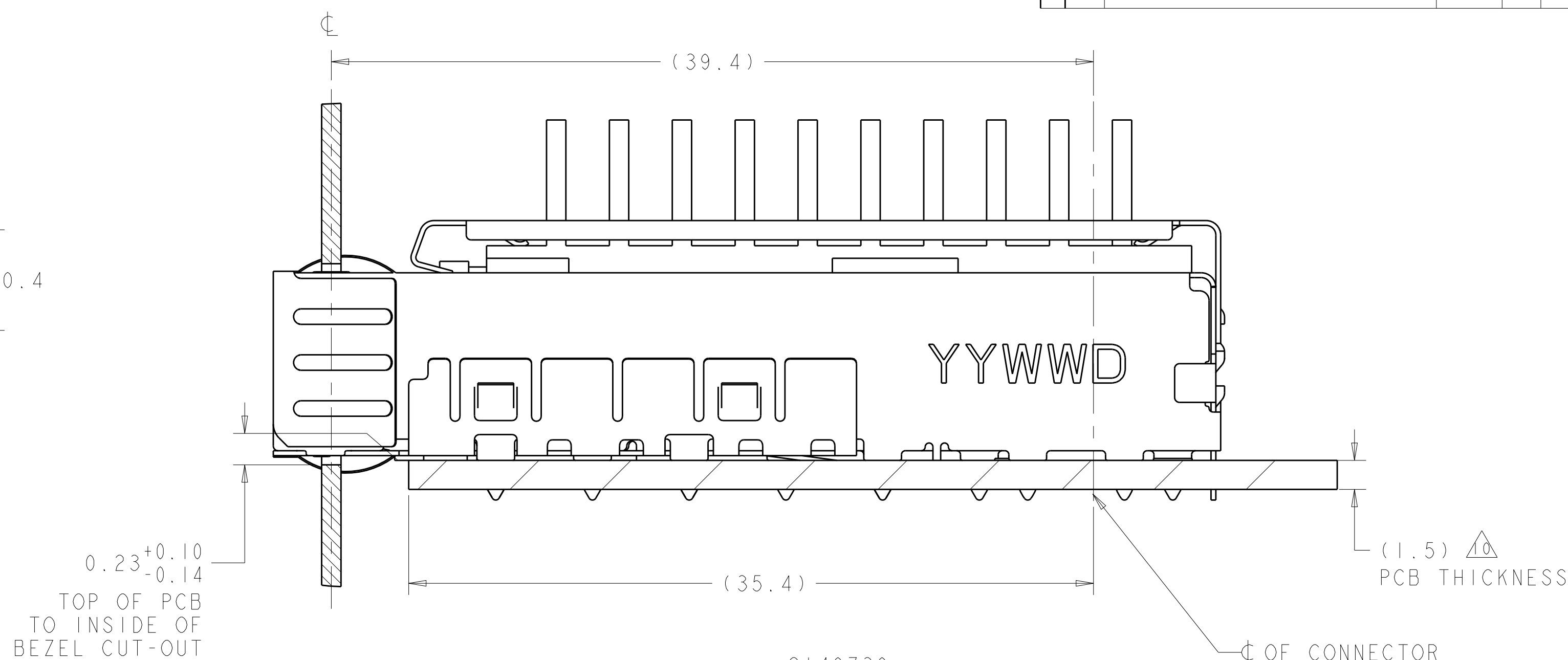
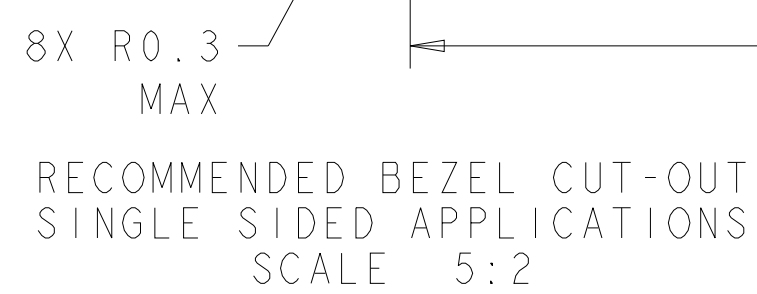
13 DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE



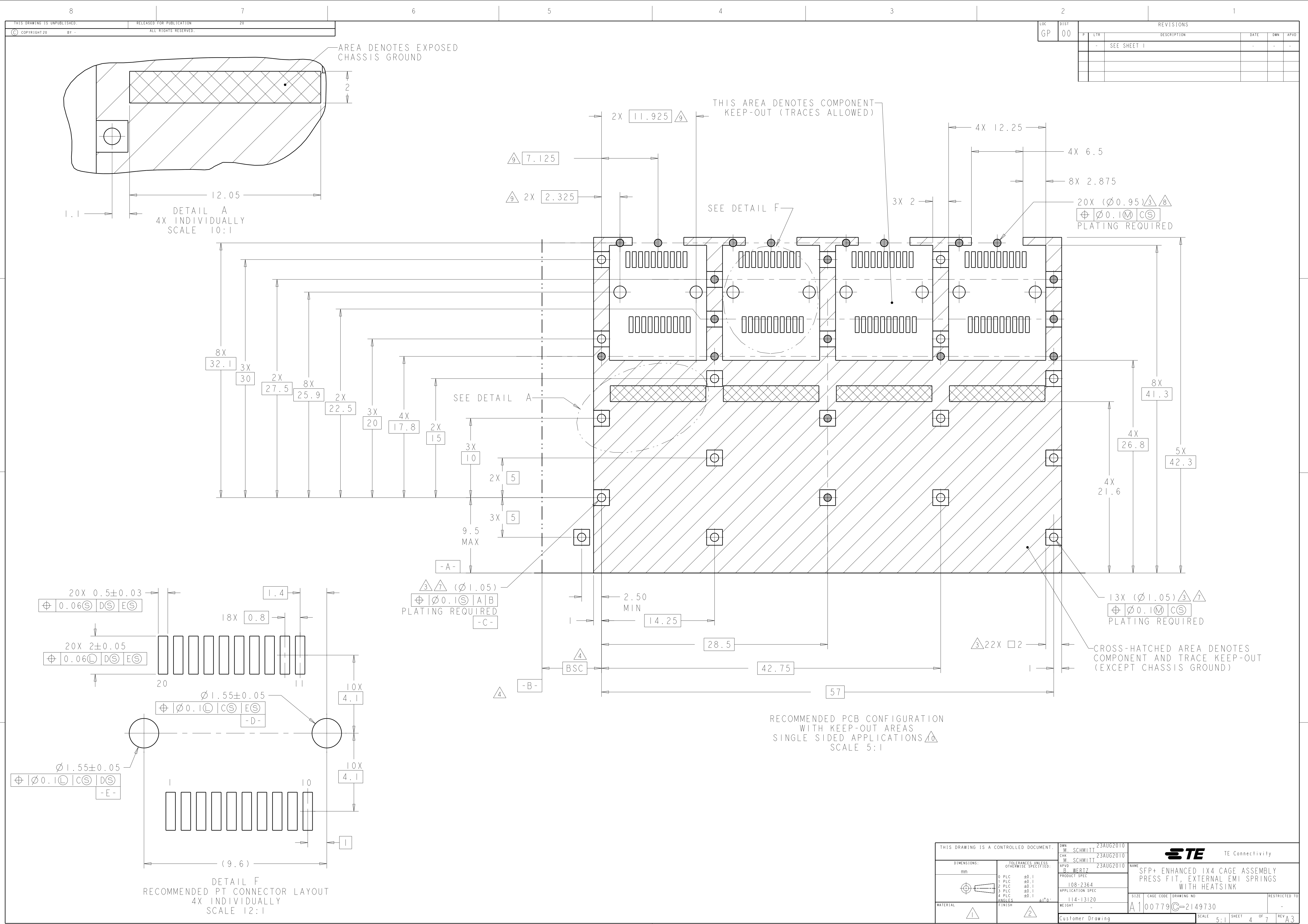
2149730-1,2,3,4,5
MOUNTED BELLY TO BELLY ON PCB
SCALE 4:1

FIN TYPE	W/ INSULATING TAPE	22.5	NETWORKING, TALL	2149730-10
FIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	22.5	NETWORKING, TALL	2149730-9
FIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	15.5	SAN	2149730-8
FIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	13.2	PCI	2149730-7
FIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	18.1	NETWORKING, SHORT	2149730-6
PIN TYPE	W/ INSULATING TAPE	22.5	NETWORKING, TALL	2149730-5
PIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	22.5	NETWORKING, TALL	2149730-4
PIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	15.5	SAN	2149730-3
PIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	13.2	PCI	2149730-2
PIN TYPE	W/O INSULATING TAPE	18.1	NETWORKING, SHORT	2149730-1
HEAT SINK TYPE	DESCRIPTION	A MAX	APPLICATION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. SCHMITT 23AUG2010	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK M. SCHMITT 23AUG2010		
mm		APVD B. WERTZ 23AUG2010	NAME SFP+ ENHANCED 1X4 CAGE ASSEMBLY PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
0 PLC ±0.1		108-2364	A100779C=2149730	
1 PLC ±0.1		APPLICATION SPEC	RESTRICTED TO	
2 PLC ±0.1		114-13120	Customer Drawing	
3 PLC ±0.1		WEIGHT	SCALE 5:1	
4 PLC ±0.1		FINISH	SHEET 1 OF 7	
ANGLES ±1°			REV A3	

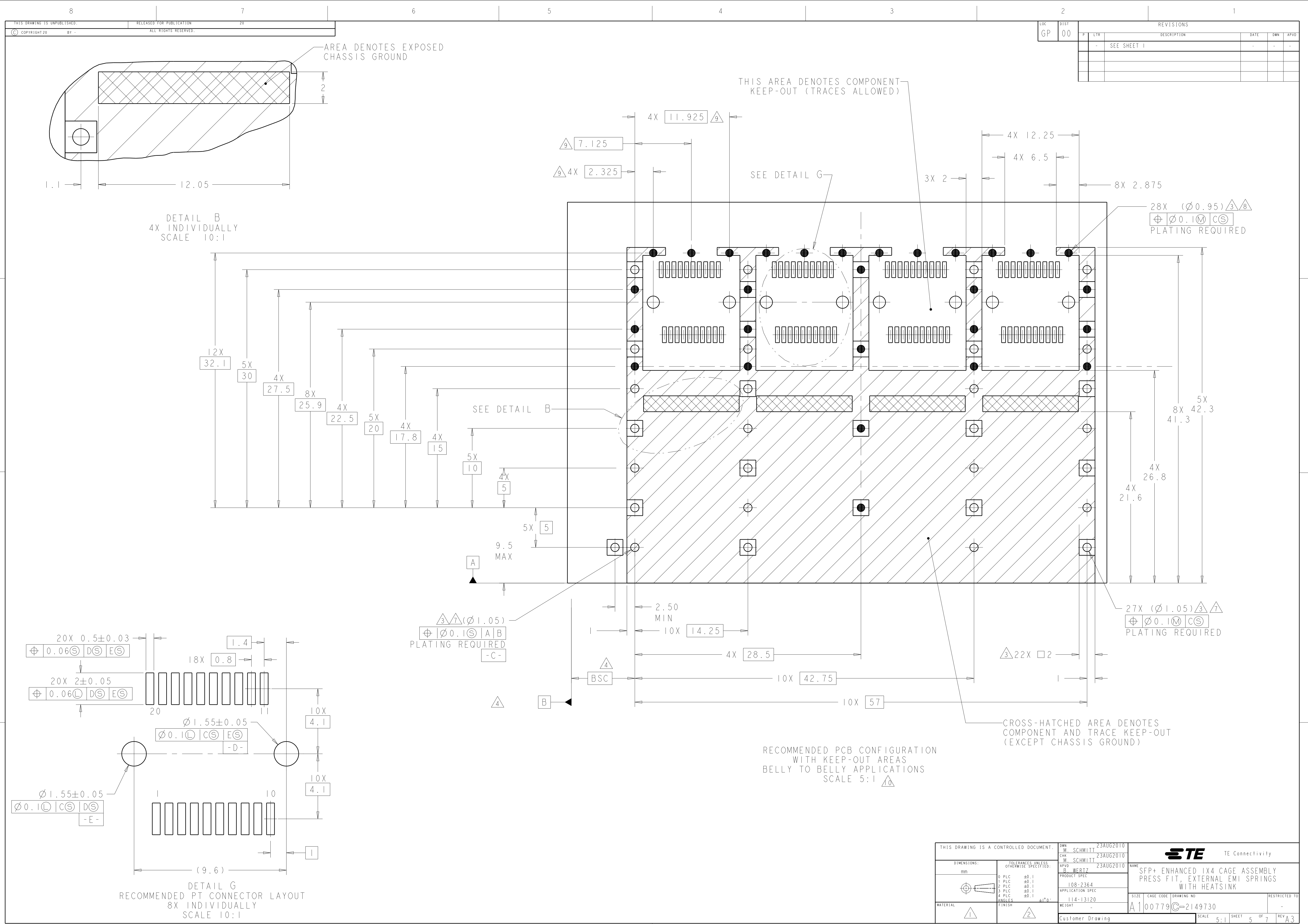


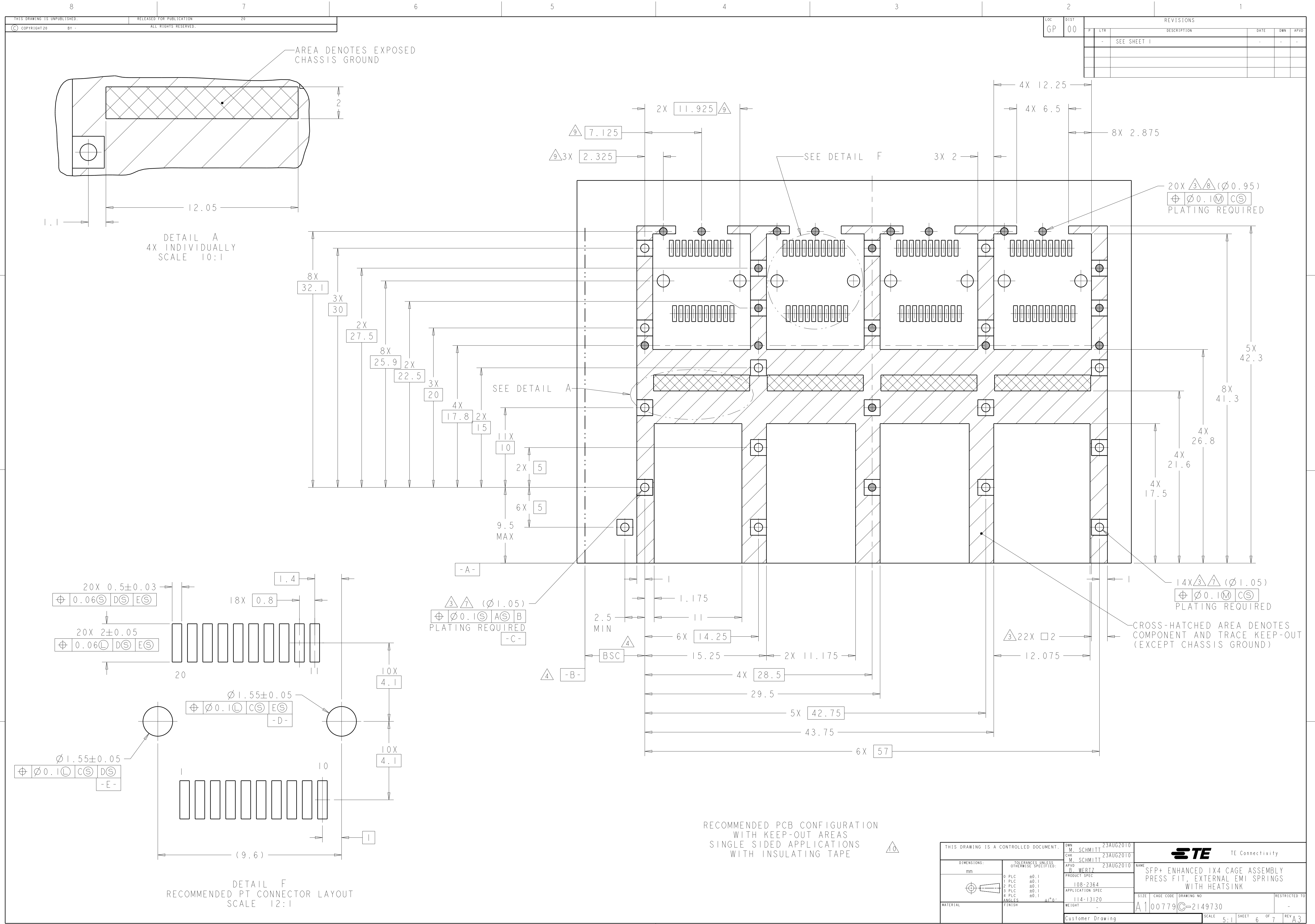
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 23AUG2010 M. SCHMITT CHK 23AUG2010 M. SCHMITT APPR 23AUG2010 B. WERTZ		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: Ø PLC ±0.1 PLC ±0.1 108-2364 APPLICATION SPEC 114-13120 WEIGHT -		NAME SFP+ ENHANCED 1X4 CAGE ASSEMBLY PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK	
MATERIAL 		FINISH 		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A100779C2149730	
Customer Drawing		SCALE 5:1		SHEET 3 of 7 REV A	



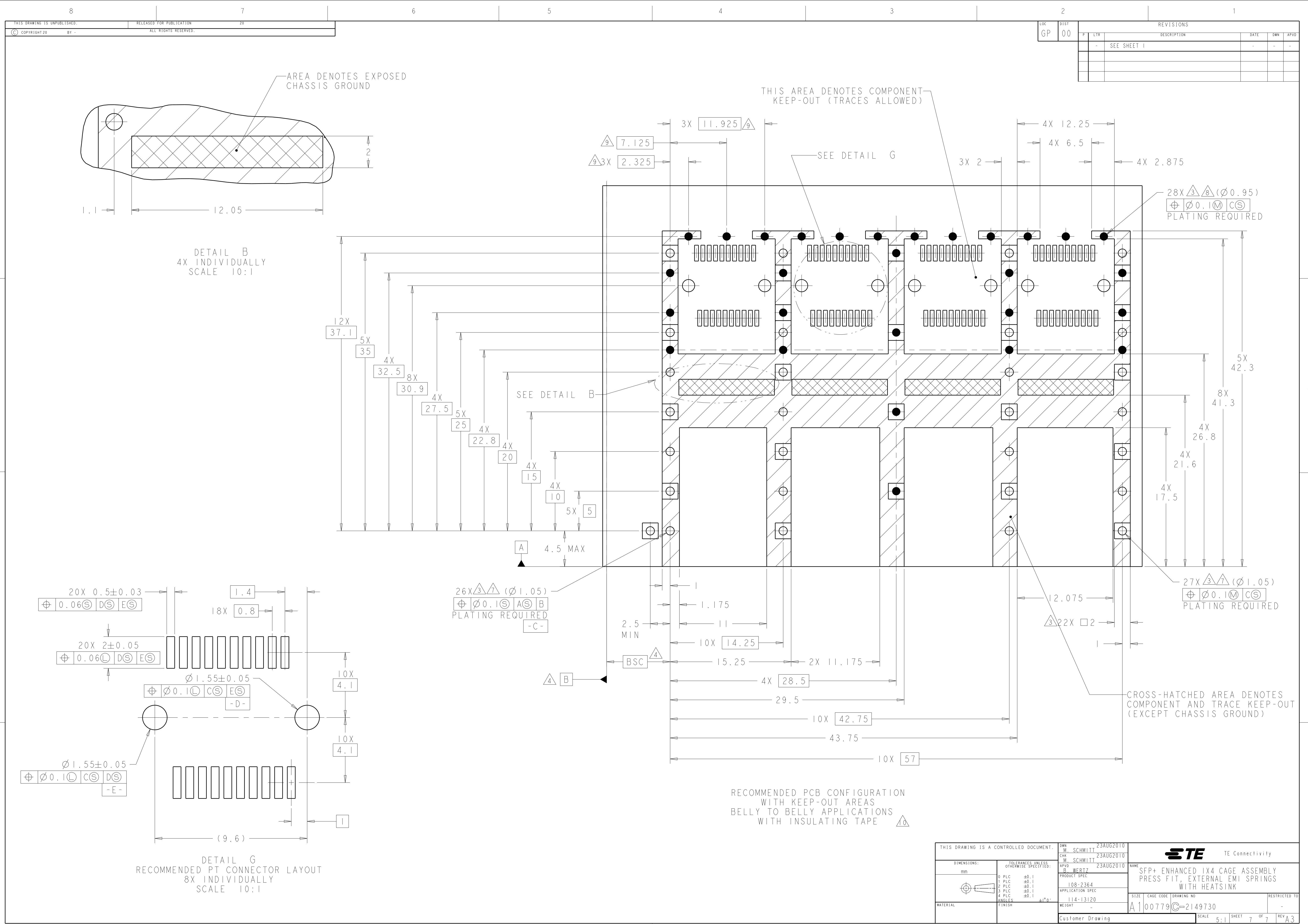
LOC		DIST		REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	M. SCHMITT	23AUG2010	TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK	M. SCHMITT	23AUG2010				
mm		APVD	B. WERTZ	23AUG2010	NAME			
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			SFP+ ENHANCED 1X4 CAGE ASSEMBLY			
		0 PLC ±0.1			PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS			
		1 PLC ±0.1			WITH HEATSINK			
		2 PLC ±0.1			SIZE			
		3 PLC ±0.1			CAGE CODE			
		4 PLC ±0.1			DRAWING NO			
		ANGLES ±1°			RESTRICTED TO			
		FINISH			A100779C=2149730			
MATERIAL		WEIGHT			-			
		Customer Drawing			SCALE 5:1 SHEET 4 OF 7 REV A3			





LOC		DIST		REVISES			
GP		00		DATE	OWN	APVD	
				SEE SHEET 1	-	-	-



2									
LOC		DIST		REVISIONS					
GP		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.